PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06096988 A

(43) Date of publication of application: 08.04.94

(51) Int. CI

H01G 4/12 H01B 1/16

(21) Application number: 04242974

(22) Date of filing: 11.09.92

(71) Applicant:

ASAHI CHEM IND CO LTD

(72) Inventor:

YOKOYAMA AKINORI

(54) PASTE FOR FORMING INTERNAL ELECTRODE OF MULTILAYER CERAMIC CAPACITOR AND MULTILAYER CERAMIC CAPACITOR EMPLOYING THE PASTE

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a paste for forming an internal electrode of multilayer ceramic capacitor through low temperature burning which exhibits excellent oxidation resistance against dielectric and excellent migration resistance between internal electrodes, and to obtain a multilayer ceramic capacitor employing that paste.

CONSTITUTION: A paste having composition shown by

where ratio), $(0.05 \le x \le 0.4,$ atomic Ag_xCu_{1-x} concentration of silver on the surface is higher than other part and average grain size of copper alloy powder is $0.1-5\mu m$), is laminated through printing on a dielectric and then it is burnt to produce an internal electrode. The internal electrode for low temperature burning multilayer ceramic capacitor obtained through burning at 120°C or below exhibits excellent oxidation resistance against dielectric and excellent migration resistance causing no short circuit between the internal electrodes. It also matches well with external electrode over a wire compositional range thereof.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-96988

(43)公開日 平成6年(1994)4月8日

(51)Int.Cl.⁵

H 0 1 B

識別配号

庁内整理番号

FI

技術表示箇所

H 0 1 G 4/12

1/16

3 6 1

A 7244-5G

審査請求 未請求 請求項の数 9(全 7 頁)

(21)出願番号

特願平4-242974

(71)出願人 000000033

旭化成工業株式会社

(22)出願日

平成 4年(1992) 9月11日

大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

(72)発明者 横山 明典

岡山県倉敷市潮通3丁目13番1 旭化成工

業株式会社内

(54)【発明の名称】 積層セラミックコンデンサー内部電極用ペースト及び該ペーストを用いた積層セラミックコンデ ンサー

(57)【要約】

【目的】 低温度で焼成される積層セラミックコンデンサーの内部電極として、誘電体に対する優れた耐酸化性、内部電極間の優れた耐マイグレーション性を有する内部電極用ペースト及び該ペーストを用いた積層セラミックコンデンサーを提供するものである。

【構成】 $Ag_x Cu_{1-x} (0.02 \le x \le 0.4$ 、原子比)組成で、表面の銀濃度が平均の銀濃度より高く、平均粒子径が $0.1 \sim 5 \mu m$ である銅合金粉末からなる積層セラミックコンデンサー内部電極用導電性ペースト及び、ペーストを誘電体に印刷積層、焼成してなる内部電極を有する積層セラミックコンデンサー。

【効果】 1200℃以下で焼成して得られる低温焼成型積層セラミックコンデンサーの内部電極として、誘電体にも酸化されない優れた耐酸化性及び内部電極間での短絡を生じない優れた耐マイグレーション性を有している。また、幅広い組成の外部電極体とのマッチング性にも優れる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式 Ag_xCu_{1-x} (ただし、0.005 $\le x \le 0.4$ 、原子比)で表され、且つ粒子表面の銀濃度が平均の銀濃度より高く、表面に向かって銀濃度が増加する領域を有する平均粒子径 $0.1\sim 5~\mu$ mである銅合金粉末からなることを特徴とする積層セラミックコンデンサー内部電極用ペースト。

【請求項2】 請求項1記載の内部電極用ペーストに、 銅合金粉末100重量部に対してさらにガラスフリット 0.1~20重量部添加してなることを特徴とする積層 セラミックコンデンサー内部電極用ペースト。

【請求項3】 請求項1または2記載の内部電極用ペーストをビスマス層状化合物(Bi_2O_2)($Me_{m-1}R$ mO_{3m+1})(ここで、Meは1~3価の元素、Rは4、5価の元素およびこれらの元素を組み合わせたもの)からなる誘電体グリーンシート上に印刷し、積層してなるグリーンシート積層体。

【請求項5】 請求項1または2記載の内部電極用ペーストをPbTiO3を主成分にした誘電体グリーンシート上に印刷し、積層してなるグリーンシート積層体。 【請求項6】 請求項1または2記載の内部電極用ペーストをPbZrO3を主成分にした誘電体グリーンシート 計画体。 【請求項7】 請求項3~6のいずれかに記載のグリーンシート積層体を500~1200℃の温度で焼成してなる誘電体によって酸化されにくい一般式AgxCu ただし、0.005 \leq x \leq 0.4、原子比)の内部電極を有する積層セラミックコンデンサー。

【請求項8】 請求項7記載の内部電極に含まれる銅酸化物存在比が20%以下であることを特徴とする積層セラミックコンデンサー。

【請求項9】 請求項7または8記載の積層セラミックコンデンサーの外部電極として、Ag、Cu, Pdから選ばれた1種以上の成分よりなる金属あるいは合金であることを特徴とする積層セラミックコンデンサー。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】電子部品として幅広く用いられているコンデンサーとして、アルミ電解コンデンサー、タンタルコンデンサー、積層セラミックコンデンサーなどあるが、本発明は、何十層の誘電体素体を重ね合わせた積層セラミックコンデンサーの内部電極に使用する銅合金粉からなる導電性ペースト及び該ペーストを用いた積

層セラミックコンデンサーを提供するものである。 【0002】

【従来の技術】従来より、幅広く用いられてきた積層セラミックコンデンサーは、主としてチタン酸塩からなる誘電体と内部電極が交互に何層にも積層されたものであるが、内部電極としては、白金、パラジウム、銀ーパラジウム、ニッケル、銀、銅などがある。作製法として、前記導電粒子からなる導電性ペーストを誘電体上に印刷し、印刷された誘電体を内部電極、誘電体が交互にくるように何層にも積層させ焼成して作製される。焼成温度は、内部電極に使用される導電体の融点より低い温度で行われている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】白金、パラジウム内部 電極を用いたものでは、非常にコスト高になると、外部 電極材料が内部電極とのマッチング性(合金化)のため 銀および銀パラジウム系に制限される。また、積層セラ ミックコンデンサー自体の容量の限られた材料しか使用 できないなどの制限がある。つまり、公知誘電体とし て、例えばチタン酸バリウム、チタン酸ストロンチウ ム、チタン酸カルシイウムなどがあるが、焼結温度が高 く、そのため内部電極としても白金、パラジウムなど1 000~1300度の高温度で焼成するものでないと温 度に耐えられなく、誘電体組成が限られる。また、低温 度で焼成される鉛系の誘電体素体が公知であるが(特開 平4-170355号)、白金、パラジウムなどの高温 度での焼結するタイプのものでは充分な焼結性が得られ ない。そのため、銀、銅、銀-パラジウムなどが用いら れてきている。

【0004】銀ーパラジウム系の内部電極の場合、コスト高になるのみならず、誘電体素体間隔が狭くなっていく上で銀のマイグレーションの問題があり、内部電極どうしが短絡し、容量不足になり易い。銀内部電極は、誘電体素体間隔が狭まるなかで、内部電極間のマイグレーションの問題があり、容量が不十分になる。

[0005] 銀ペーストを用いた銅内部電極も公知であるが、一般に何層に積層された公知内部電極自体は誘電体素体より薄く1~数 μ mの厚さであるため、焼成時、誘電体素体の酸化物が内部電極の銅を酸化させ易く、そのため内部電極の酸化による断線が起こり機能が充分に発揮されないなどの重大な問題点がある。また、焼成雰囲気としては、銅ペーストは窒素中で焼成しなくてはならなく、そのため、ペースト中に含まれる有機パインダーの焼き飛びが不十分になる。したがって、焼成時、酸素を窒素雰囲気中でドープして行うが、内部電極層がもともと0.1~数 μ m程度と薄いことで使用される導電性粒子が焼結中に酸化をうけ焼結不十分となり、その結果、電気容量が不足になるという問題もある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者は、前記課題を

鋭意検討した結果、本発明に達した。すなわち、本発明は、一般式Ag、Cu_{1-x}(ただし、 $0.005 \le x \le 0.4$ 、原子比)で表され、且つ粒子表面の銀濃度が平均の銀濃度より高く、表面に向かって銀濃度が増加する領域を有する平均粒子径が $0.1\sim 5~\mu$ mである銅合金粉末からなることを特徴とする積層セラミックコンデンサー内部電極用ペースト、及び該ペーストを誘電体上に印刷し、積層してなるグリーンシート積層体、及び該グリーンシート積層体を $500\sim 1200$ での温度で焼成してなる内部電極を有する積層セラミックコンデンサーに関する。

【0007】本発明の内部電極用ペーストは銀、銅を主 ·成分にした銅合金粉末であるが、銀量が 0. 4を超える 場合には、誘電体素体間の銀のマイグレーションが問題 になる。0.005未満の場合には、誘電体により内部 電極が酸化を受け容量が不足になる。好ましくは、銀量 が0.01~0.3である。また、該組成の銅合金粒子 は表面が平均の銀濃度より高く、且つ粒子表面に向かっ て銀濃度が増加する領域を有しているが、以下の利点が ある。すなわち、内部電極ペーストとして印刷後、焼成 する場合、不活性雰囲気中で焼成するのが好ましく、ペ ーストに含まれる有機ピヒクルを完全に焼き飛ばすのに さらに微量の酸素を添加するのが好ましいが、この時、 表面に銀濃度が高いことで焼結時の酸化が防止できる。 しかも粒子内部に向かって銀濃度が減少しているため焼 結時の層間でのマイグレーションにも優れるという利点 を有している。そのため、表面の銀濃度が平均の銀濃度 より高いことがよく、2倍以上30倍以下が好ましく、 さらに、3倍以上27倍以下が好ましい。

【0008】また、本発明で用いる銅合金粉末の平均粒 子径は $0.1\sim5\mu m$ であるが、平均粒径が $5\mu m$ を超 える場合には、内部電極層が厚くなり、充分な数の積層 体が得られず、また、焼結も不十分になる。平均粒子径 が $0.1 \mu m$ 未満の場合には、誘電体により該組成のペ ーストを用いた内部電極体が酸化され易くなるため容量 が不安定になる。好ましくは、 $0.1 \sim 3 \mu m$ である。 表面の銀濃度の測定は、XPS(X線光電子分光分析装 置; XSAM800 KRATOS社製) を用いて以下 の条件で行った。エッチング条件; アルゴンイオン 10⁻⁷torr 10分間 12keV測定条件; ア ルゴン雰囲気中 10-8torr、試料台上に、両面テ ープを張り付けさらに、粉末を全面が覆うように張り付 けて取り出し角度90℃で測定した。測定、エッチング を繰り返し行い、5回繰り返し行った。最初の2回の平 均値を表面の銀濃度とした。銀濃度xはAg/(Ag+ Cu)、銅濃度はCu/(Ag+Cu)とした。また、 平均の銀、銅濃度は、濃硝酸に銅合金粉末を溶解して「 CP(髙周波誘導結合型プラズマ発光分析計、セイコー 電子製)で測定した。

【0009】平均粒子径は、レーザー回折型平均粒子径

測定装置(島津製作所製SALD1100)を用いて体 積積算平均粒子径を用いた。銅合金粉末の形状は、特に 指定はないが、内部電極が薄いことや、焼結性の点から 球状あるいは球状に近いものが好ましい。しかし、特性 を損なわない程度で有れば多少球状以外の形状粉末(鱗 片粉、不定形粉)を含んでいても構わない。

【0010】また、誘電体との優れた接着性を確保するためガラス粉末をペーストに混合して用いることもできる。ガラス粉末を用いる場合には、誘電体素体と充分な接着力を有するものが好ましく、PbO, B_2O_3 , SiO_2 、Zno, CaO, MgOなどから選ばれた1種以上の成分からなるガラス粉末が好ましい。ガラス粉末の添加量としては、銅合金粉末100重量部に対して、 $0.1\sim20$ 重量部が好ましく、 $0.1\sim15$ 重量部が好ましい。ガラス粉末としては、平均粒子径が 3μ m以下のものが好ましく、さらに、 2μ m以下のものが好ましい。また、必要に応じて、ガラス粉末をペーストに混合して用いることもできる。

【0011】本発明の積層セラミックコンデンサーの内部電極用ペーストは、誘電体素体に印刷あるいは塗布して用いるため、適度なチキソ性、印刷性が必要である。そのため、ペーストとして、有機ビヒクルを適当量含有していることが好ましい。有機ビヒキルは公知のもので構わないが、焼成条件で充分に焼き飛ぶものが好ましい。例えば、エチルセルロース系、アクリル樹脂系、ポリビニルブチラール系、エポキシ系などが挙げられるが特に指定するものではない。この場合、溶剤とともに用いるのが好ましい。溶剤としては、公知の溶剤で、印刷時のチキソ性、焼成時の揮発性を有するものであれば特に指定はない。銅合金粉末100重量部に対して1~300重量部が良いが、特に必要で有れば、減量して用いることもできる。

【0012】その他、添加物として、チキソ剤、沈降防 止剤、銅合金分の銅酸化物の還元剤を用いることもでき る。添加剤の量としては、銅合金粉末100重量部に対 して50重量部以下が好ましく、特に、0.1~40重 量部が好ましい。本発明の内部電極用導電性ペーストを 使用する場合、誘電体素体は公知のものが使用できる が、誘電体の焼成温度が1080℃未満のものが良い。 1080℃を超える場合には、本発明で用いる銅合金粉 末がすべて融解し流れだし、内部電極として不十分にな る。好ましくは1050℃以下600℃以上で焼成され る誘電体が良い。ビスマス層状化合物 (Bi₂O₂) $(Me_{n-1} RmO_{3n+1})$ ここで、Meは1~3価の元素、Rは4、5価の元素およびこれらの元素を組み合わ せたものや (例えばBi₂WO₆、Bi₂W_mMo_{1-m} O₆、Bi₄Ti₃O₁₂など)、Pbを主成分にした ペロブスカイト型組成物 (例えばPb(M*、M**_{1-x}) 1-, O3 (ただし、M'はFe、Co、Zn、Mg, N i, M"dW, Nb, Ta, x tl 1/3, 1/2, 2/

3)で表される)ものである。例えばPb ($Fe_{1/2}$ N $b_{1/2}$) O_3 などである。また $PbTiO_3$ やPbZr O_3 などが挙げられる。これらの誘電体に必要に応じて、Mg, Zn, Nb, Ni, Ti, Agateを添加した鉛系の酸化物誘電体などが好ましい。その他、チタン酸系の酸化物誘電体も用いることができる。これらの酸化物誘電体を用いても本発明の内部電極用ペーストは優れた耐酸化性を有している。

【0013】本発明のペーストを用いた内部電極の形成 方法としては、先ず、誘電体組成の粉末と有機ピヒクル を混合し、調製されたペーストをドクターブレード法、 スプレー法、カレンダーロール法、スクリーン印刷法、 ドローイング法などによりグリーンシートを作製する。 こうして得られたグリーンシートを所定の大きさにパン チングで打ち抜く。このグリーンシートに本発明の内部 電極用ペーストを印刷する。印刷されたグリーンシート を何層か積み重ねて、圧着しこれを切断して生チップを つくる。積層セラミックコンデンサーの大きさとして、 3. 2×1 . 6 mm, 1. 6×0 . 8 mm, 1×0 . 5 mmなどの公知の大きさが使用できる。このチップを所 定の温度で焼成する。所定の温度としては、1050℃ 以下550℃以上が良く、さらに、1000℃以下65 0℃以上が良い。この温度処理により電極が誘電体表 面、層間に形成される。有機ピヒクルを完全に焼き飛ば すためには酸素を窒素中にドープするのが好ましい。焼 成する場合、550~600℃程度まで酸素ドープする のが好ましい。ドーブ量としては、5 p p m ~ 1 5 0 p pm程度で充分である。

[0014]内部電極としては、厚さ 10μ m以下が積層体の積層数の関係から好ましく、厚さ $0.1\sim7\mu$ mが好ましい。本発明の内部電極ペーストを用いて形成させた場合、導電性ペーストを印刷し、焼成されるが、この時の雰囲気中での酸化に対して優れるのみならず誘電体(酸化物成分)からの酸化にもわずか数 μ mの膜厚であるにもかかわらず優れており、誘電特性の安定したものが得られる。

【0015】本発明の内部電極が形成された積層の誘電体の内部電極の端子に外部電極を塗布焼成して積層セラミックコンデンサーとして用いられる。特に、外部電極としては、銅、銀、銀ーパラジウム、銅ー銀合金など公知の材料を充分に用いることができる。すなわち、内部電極は一般式AG、Cu₁-x(ただし、0.005≦x ≤0.4、原子比)からなる導電体であるが、従来の銅の欠点である誘電体による酸化、銀の欠点であるマイグレーション性がなく、且つパラジウムにはない良好なっているため、外部電極としての銀、銅、パラジウム、銀ーパラジウム、銀ー銅のいずれとも充分に合金化できるため、従来にない優れた外部電極とのマッチング性を有している。中でも銀ー銅合金外部電極体を用いるのが

好ましい。

【0016】本発明の内部電極用ペーストを用いたセラ ミックコンデンサーの容量値はLCRメーター(日置 製) により1MHzで測定し、さらに、150℃ 30 分間~-55℃ 30分間 1000サイクルでの試験 後の測定値との変化率(試験後の変化率)を測定した。 変化率10%以下が良好であるとした。以下に実施例に より本発明を説明する。また、内部電極の酸化性を測定 するため、積層体をエッチングして内部電極を露出さ せ、薄膜X線(理学製MXP18)により0.5度の入 射角、電流値100mA、電圧100kVで銅酸化状態 を測定した。酸化第一銅のメインピーク、酸化第二銅の メインピーク、銅メタルのメインピークの測定強度より 酸化物存在比はCuOx/(CuOx+Cu)をもって 表した(ただし、СиОхは酸化第一銅、酸化第二銅の 和)。20%以内を良好とした。20%を超える場合に は、内部電極の一部で断線が生じてきて容量が不十分に なる。

[0017]

【実施例】

粉末作製

[0018]

【作製例1】 銅粉末(純度99.9%以上)180.975g、銀粉末(純度99.9%以上)16.2gを充分に混合し、黒鉛るつぼに入れ高周波誘導加熱を用いて1800℃まで窒素雰囲気中で加熱溶解した。融液を窒素雰囲気中へ噴出し、噴出と同時にボンベ入り窒素ガス130kg/cm²Gを融液に対して噴出し、融液をアトマイズした。得られた粉末の平均粒子径は6μmであった。この粉末の中、2μm以下の粉末を分級し取りだした。平均粒径1μmの粉末の表面の銀濃度は、表面より0.76、0.66、0.5、0.45、0.3であり、表面の銀濃度は0.71であった。平均の銀濃度は0.05であり、表面の銀濃度は平均の銀濃度の14倍であった。

[0019]

【作製例2】銅粉末(純度99.9%以上)152.4g、銀粉末(純度99.9%以上)64.8gを充分に混合し、黒鉛るつぼに高周波誘導加熱を用いて窒素雰囲気中1850℃まで溶解し、さらに、窒素雰囲気中ボンベ入り窒素ガス150kg/cm²Gで融液をアトマイズした。得られた粉末は、8μmの球状粉であった。得られた粉末の中1μm以下の粉末を分級した。平均粒子径0.6μmの粉末の表面の銀濃度は、表面より0.8、0.78、0.7、0.6、0.5であり、表面の銀濃度は0.79であった。平均の銀濃度は0.2であり、表面の銀濃度は平均の銀濃度の3.95倍であった。

[0020]

[作製例3] 銅粉末 (純度99.9%以上) 189.5

g、銀粉末 (純度99.9%以上) 1.62gを混合し、同様にして1800℃まで窒素雰囲気中で融解した。融液を窒素雰囲気中でボンベ入り窒素ガス(180kg/cm²G)で融液をアトマイズした。得られた粉末は、平均粒子径5 μ mであった。そのうち1 μ m以下の粉末を分級した。平均粒子径0.4 μ mであった。表面の銀濃度を測定すると、表面より0.04、0.03、0.02、0.2、0.01であり、表面の銀濃度は0.035であった。平均の銀濃度は0.005であり、表面の銀濃度は、平均の銀濃度の7.5倍であった。ペースト実施例

[0021]

【実施例1】作製例1で得られた平均粒子径1 μ mの粉末10g、エチルセルロース0.03g、テルペノール0.5g、PbO-B $_2$ O $_3$ -ZnOガラスフリット0.1gを充分に混合しペーストとした。得られたペーストをBi $_2$ WO $_6$ からなる誘電体グリーンシート上に

塗布した。塗膜を40層積層させた後、3.6mm×1.6mmにカットし、870℃窒素雰囲気中で焼成した。この時、550℃まで酸素100ppmドープした。一部サンプルを取り出し、内部電極層の厚さを測定したところ、 5μ mであった。

【0022】内部電極を作製後、同じ組成のペーストを外部電極として内部電極面が露出している面に全面に塗布した。さらに、870℃で窒素雰囲気中で焼成した。電極を通して容量を測定したところ、規格値の±5%以内であった。 t a n δ も 0.2%であった。外部電極間に50 Vを印可し、60℃ 90%相対湿度中で1000時間放置後、内部電極を割って走査型電子顕微鏡で測定したところ内部電極間にマイグレーションは観測されなかった。

[0023]以下実施例2~5については表に示す。[0024]

706からなる誘電体グリーンシート上に 【表1】						
2	3	4	5			
作製例1	作製例2	作製例3	作製例4			
1	0.6	0. 4	1			
Pb0-B ₂ 0 ₃	Pb0-Si0 ₂	Pb0-B ₂ O ₃ -ZnO	Pb0-B ₂ O ₃ -Ca0			
3	2	1	1			
以双層状	鉛ベロブスカイト	PbO-BaTiO₃	Bi 2406			
化合物	Pb(Fe ₂ / ₃ W ₁ /	3)03				
Bi 4Ti 3012	Pb(Fe _{1/2} Nb ₁	₂)0 ₃	•			
50	50	40	40			
890	900	900	890			
室素	室素	窒素	空素			
10ppm	20ppm	10ppm	20ppm			
5	4	6	8			
-2%	-1%	+ 1 %	+2%			
0.2%	0.1%	0. 4%	. 0.3%			
ンなし	なし	なし	なし			
1 %	2%	3 %	0.5%			
銀	銀一銅	銀一バラジウム	銀			
良好	良好	良好	良好			
	2 作製例1 1 PbO-B ₂ O ₃ 3 以不物 Bi ₄ Ti ₃ O ₁₂ 50 890 室素 10ppm 5 -2% 0.2% か 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	2 3 作製例1 作製例2 1 0.6 Pb0-B203 Pb0-Si02 3 2 比マス層状 鉛ペロブスかんト 化合物 Pb(Fe2/3W1/8i4Ti3012 Pb(Fe1/2Nb150 50 50 890 900 空素 空素 10ppm 5 4 -2% -1% 0.2% 0.1% ひなし なし なし 1% なり 銀一鍋	2 3 4 作製例1 作製例2 作製例3 1 0.6 0.4 Pb0-B203 Pb0-Si02 Pb0-B203-Zn0 3 2 1 Eスス層状 鉛ペロブスカイト Pb0-BaTi03 化合物 Pb(Fe2/3W1/3)03 Bi4Ti3012 Pb(Fe1/2Nb1/2)03 50 50 40 890 900 900 空素 空素 空素 空素 10ppm 20ppm 10ppm 5 4 6 -2% -1% +1% 0.2% 0.1% 0.4% ン なし なし なし なし なし 1% 2% 3% 銀ー銅 銀ーバラ沙ム			

【比較例】粉末作製

[0025]

[0026]

【作製例4】銅粒子127g、銀粒子216gを混合し、黒鉛るつぼに入れ窒素雰囲気中で1700℃まで加熱溶解した。融液を黒鉛るつぼ先端より窒素雰囲気中へ噴出した。噴出後、融液を窒素ガス($150kg/cm^2G$)でアトマイズした。得られた粉末は平均粒子径 6μ mであった。得られた粉末の中 2μ m以下の粉末を分級した。得られた粉末の平均粒子径は 1μ mであり、平均の銀組成は0.5、平均の銅組成は0.5であった。

【作製例 5】 銅粒子 5 0 0 g を混合して、黒鉛るつぼに入れ窒素雰囲気中で 1750 ℃まで加熱溶解した。融液を黒鉛るつぼ先端より窒素雰囲気中へ噴出した。噴出後、融液を窒素ガス(150 k g/c m² G)でアトマイスした。得られた粉末は平均粒子径 5μ mであった。得られた粉末の中、 1.5μ m以下の粉末を分級した。得られた粉末の平均粒子径が 0.8μ mであった。

[0028]

【作製例6】銅粒子126.7g,銀粒子0.432gを充分に混合して黒鉛るつぼに入れ、1800℃まで窒素雰囲気中で加熱溶解した。融液を黒鉛るつぼ先端より窒素雰囲気中へ噴出した。噴出と同時に、融液を窒素ガス(150kg/cm²G)でアトマイズした。得られ

た粉末は、平均粒子径 $5~\mu$ m であった。さらに、 $2~\mu$ m 以下の粉末を分級した。得られた分級粉は $1~\mu$ m 平均径 であった。

【0029】分級粉の表面の銀濃度は表面より0.006、0.003、0.002、0.002、0.002、0.002 であり、表面の銀濃度は0.0045であった。平均の 銀濃度は0.002であり、表面の銀濃度は平均の銀濃 度の2.25倍であった。

[0030]

【作製例7】銀粒子120.65g,銀粒子10.8gを充分に混合して黒鉛るつぼに入れ、1800℃まで窒素雰囲気中で加熱溶解した。融液を黒鉛るつぼ先端より空気中で噴出した。噴出と同時に、空気(150 kg/c m^2 G)で融液をアトマイズした。得られた粉末は平均粒径8 μ mの無定形粉であった。

【0031】得られた粉末の中、 2μ m以下の粉末を分級した。分級粉の表面の銀濃度を測定したところ、表面より銀濃度が0.008、0.01、0.02、0.03、0.04で表面の銀濃度は0.09であった。また、平均の銀濃度は0.05であり、表面の銀濃度は平均の銀濃度の0.18倍であった。

[0032]

【表2】

比 較 例	1	2	3	4	5	
	作製例 4	作製例5	作製例6	作製例7	作製例1	
平均粒子径 μm	1	0.8	1	1	10	
ペーストガラス	PbO-SiO ₃	B ₂ O ₃ -SiO ₂	同左	Pb0-B ₂ 0 ₃	同左	
(対粉末 100部)	1	1	2	1	1	
誘電体	とスマス層状	同左	鉛ペロブスカイト	同左	Bi ₂ WO ₆	
	化合物	$Pb(Fe_{2}/_{3}W_{1}/_{3})O_{3}$				
	Bi 4Ti 4012					
層数	30	30	30	. 30	40	
焼成温度°C	890	900	850	870	860	
雰囲気	窒素	窒素	室素	窒素	窒素	
酸素ドープ	5ppm ·	10ppm	10ppm	10ppm	10ppm	
内部電極厚µm	5	7	6	5	12	
容量変化	-1%	40%	30%	30%	50%	
(容量/規格値)						
$ an\delta$	0.1%	1 %	0.9%	0.8%	1 %	
銅酸化物	0.5%	40%	40%	55%	30%	
マイグレーショ	ン あり	なし	なし	なし	なし	
外部電極	銅	銀	銀	銀ーバラジウム	15374	
マッチング性	良好	悪い	悪い	悪い	悪い	

[0033]

【発明の効果】本発明は、1200℃以下で焼成される 積層セラミックコンデンサー内部電極用ペーストを提供 するものであり、従来の銅ペーストでは達成できなかっ た誘電体による内部電極酸化を防止でき、また、銀で問 題となっていた内部電極間のマイグレーションが防止で きる、焼結性に優れた内部電極ペースト、および該ペーストの電極を内部に持つ積層セラミックコンデンサーである。また、外部電極とのマッチングにも優れており、 従来の限定した外部電極だけでなく、幅広い組成の外部 電極体が使用できる。